

Canon

Small sputtering equipment

小型スパッタ装置

Sputtering equipment for R&D and Small-Scale Production

研究開発装置 EB1000 / 小規模生産装置 EB1100

- **小型・低価格**
Compact and low cost
- **多層成膜に対応**
Multi-layer deposition
- **簡単操作**
Easy operation
- **高い拡張性**
High expandability

研究開発・小規模生産

Sputtering equipment for R&D and small scale production

研究開発

Sputtering equipment for R&D



EB1000



EB1100

**多様なニーズに充実の
ラインナップで応えます。**

Applicable for various needs with
abundant option

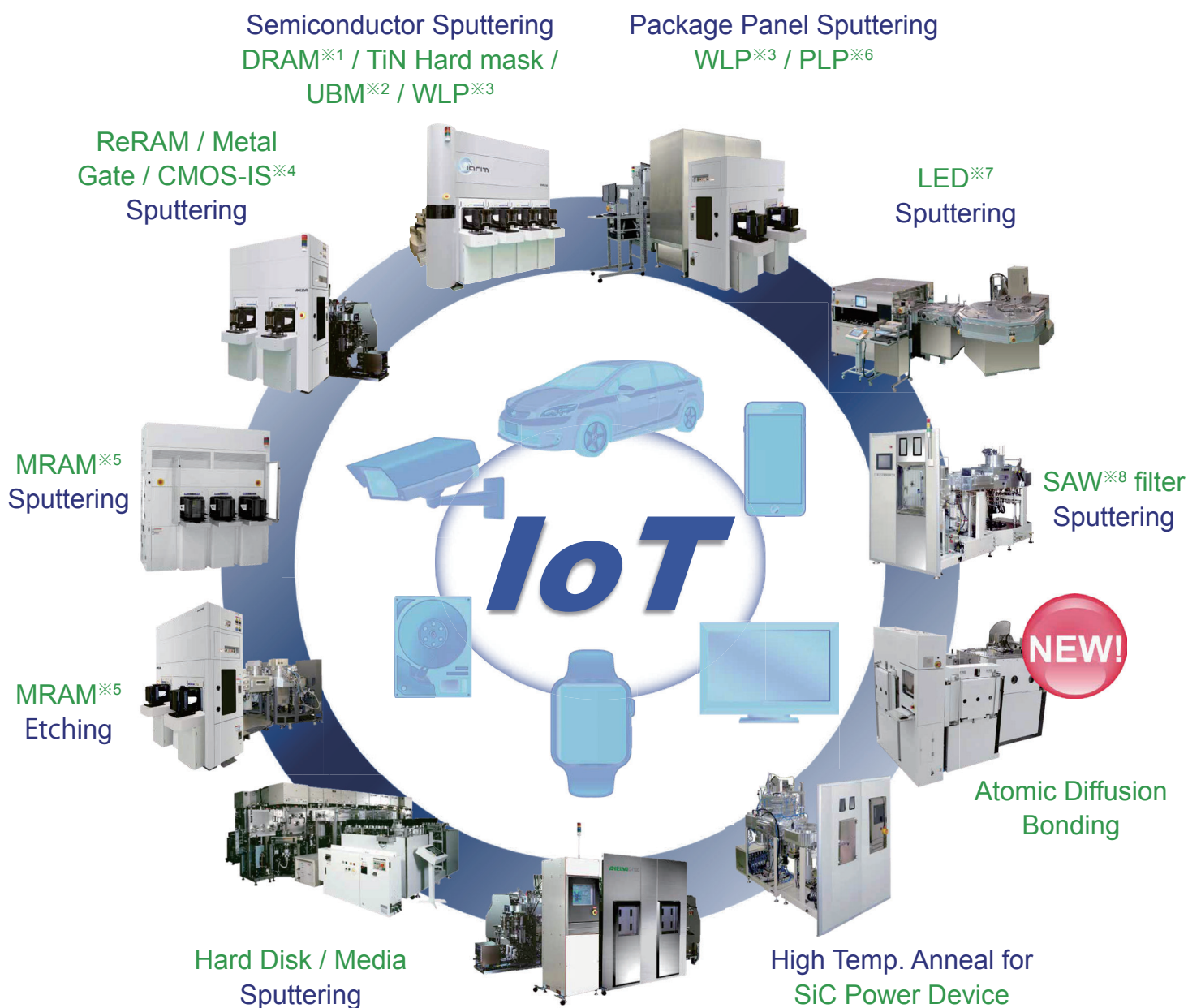
CANON ANELVA CORPORATION



Enabling nano level micro fabrication by ultra high vacuum

超高真空が実現するナノレベルの微細加工

CANON ANELVA Equipment solution キャノンアネルバの装置ソリューション



※1 : Dynamic Random Access Memory
※2 : Under Bump Metal
※3 : Wafer Level Package
※4 : Complementary Metal Oxide Semiconductor - Image Sensor
※5 : Magnetic Random Access Memory

※6 : Panel Level Package
※7 : Light Emitting Diode
※8 : Surface Acoustic Wave
IoT : Internet of Things

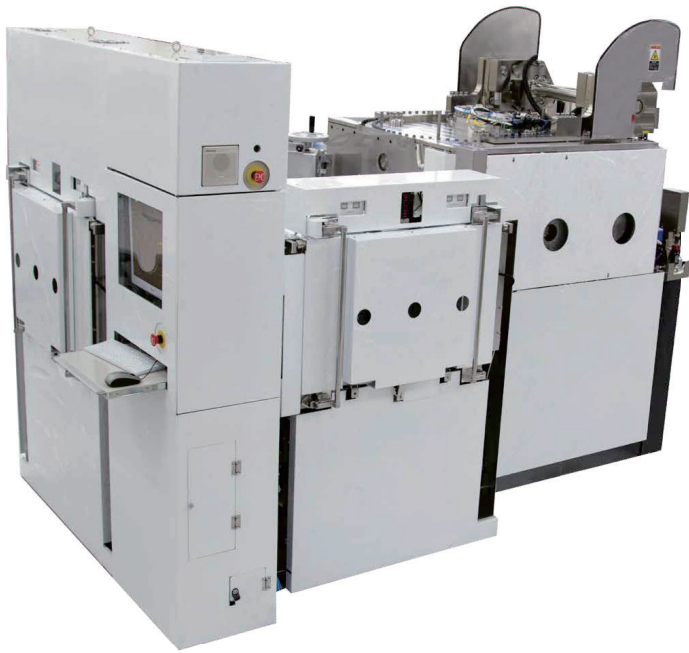


Realization of large volume production under ultra high vacuum

超高真空下で量産を実現

Atomic Diffusion Bonding Equipment BC7000

原子拡散接合装置 BC7000



優れた再現性

Excellent repeatability

Φ6インチ、Φ4インチ対応

Compatibility for 6inch and 4inch wafer

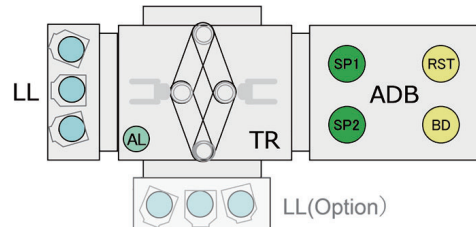
1組3.5分の高い生産性*1

High productivity of 3.5 min. for 1 set of bonding

*1: 接合基板材料、条件によります。

システム構成図

System configuration diagram



用語：LL:Load Lock Chamber / TR:Transfer Chamber / ADB:Atomic Diffusion Bonding Chamber / AL=Aligner / SP=Sputtering Holder / BD=Bonding Stage / RST=Rotary Substrate Table

ボイドフリー接合と位置合わせ技術

Void free bonding and alignment technologies

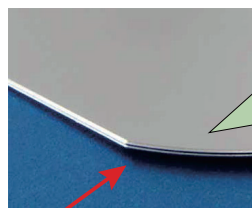
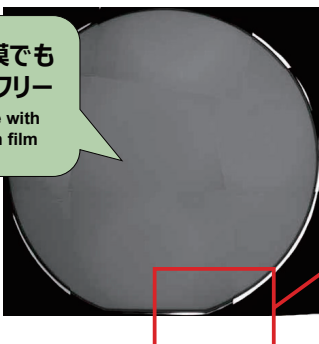
極薄膜厚の再現性

Excellent repeatability with ultra thin film control technology

赤外線透過画像
Infrared transmission image

基板外形でのアライメント
Outside form alignment

極薄膜でも
ボイドフリー
Void free with
ultra thin film

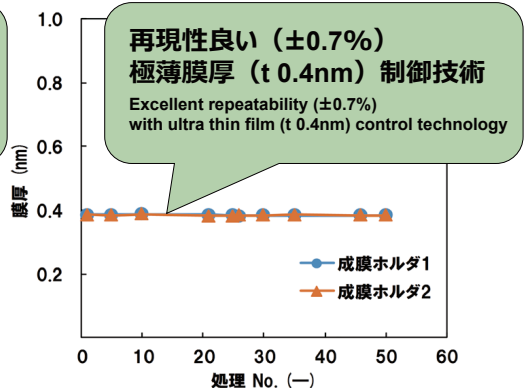


基板アライメント
マーカー不要
Free alignment marker
on the wafer

基板サイズ：Φ100mm
接合膜：Ti (t 1nm)

基板中心の膜厚再現性

Film thickness repeatability of the center



再現性良い (±0.7%)
極薄膜厚 (t 0.4nm) 制御技術
Excellent repeatability (±0.7%)
with ultra thin film (t 0.4nm) control technology